

合肥晶合集成电路股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 31 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司（含合并报表范围内子公司）在确保不影响公司日常经营业务开展及资金安全的前提下，使用不超过人民币 80 亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流通性好、中低风险、稳健型金融机构产品，授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。现就该事项的具体情况公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高公司闲置资金使用效益，在不影响正常经营和保证资金安全，并有效控制风险的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，以增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）现金管理品种

公司拟通过银行、证券公司等金融机构进行现金管理，投资品种为安全性高、流通性好、中低风险、稳健型投资产品。

（三）额度及期限

公司（含合并报表范围内子公司）拟使用不超过 80 亿元人民币（含）闲置自有资金进行现金管理，授权期限自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

（四）实施方式

董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述期限及额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（五）信息披露

公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

二、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开展，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。通过对闲置自有资金进行合理的现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司和股东利益的情形。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、本次现金管理方式是购买安全性高、流动性好、中低风险、稳健型投资产品，该类投资产品受货币政策等宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

4、公司董事会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人员在上述期限及额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

四、履行的审议程序

公司于2024年5月31日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含合并报表范围内子公司）在确保不影响公司日常经营业务开展及资金安全的前提下，使用不超过人民币80亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流通性好、中低风险、稳健型金融机构产品，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。本议案相关事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

公司在不影响正常经营并有效控制风险的前提下，对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

综上，监事会一致同意公司使用不超过人民币80亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

2024年6月1日